

# Wafer Probe



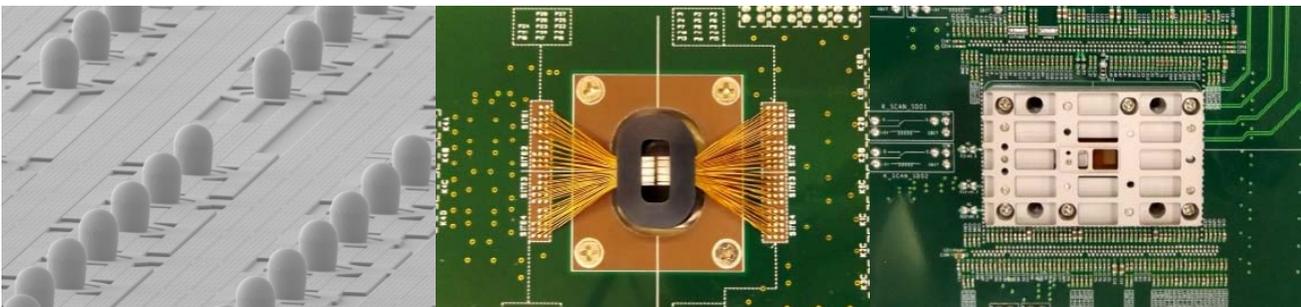
Amkor는 다양한 종류의 prober 및 기타 wafer inspection 장비를 갖추고 있으며, 향후에도 최신 장비들을 구비해 고객의 다양한 wafer test 요구사항을 충족시켜 나아갑니다. Wafer test는 wafer 상태에서 개별 die들의 electrical functionality 성능을 검사하는 공정으로, 각 device spec을 만족하는 good die들에 대해서만 선별적으로 후속 공정(bump, assy & final test)이 이루어지도록 함으로써 전체 공정비용을 줄일 수 있으며, device 특성에 따라 bumping 공정 이후의 wafer 상태에서 test가 이루어지기도 합니다.

## Operational Experience

- More than 20 years experience on 6, 8, 12" wafer probing for Logic/Mixed/Analog/RF using various type of probe cards (Cantilever, Vertical, Pogo, Membrane)

## Technical Supports

- Advanced wafer test solution (PAD, WLCSP, fine-pitch Cu Pillar)
- High parallelism, Low cost solution with high quality
- Full SW/HW development & failure analysis



## Equipment Capacity

- Full range of test platform for Logic/Mixed/Analog/RF
- Various types of prober : TEL/TSK/OPUS/EG

